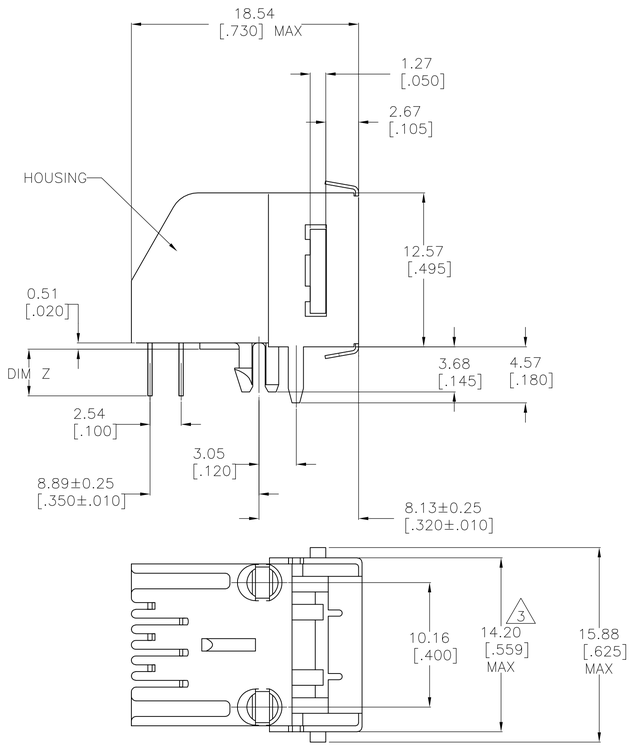
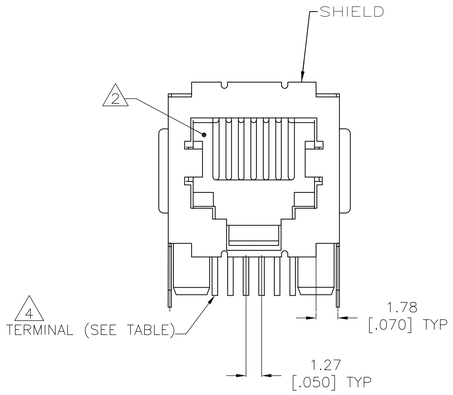
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION - ,- .
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
AA	00

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E1	REVISED PER ECO-11-005033	23MAR11	RK	HMR



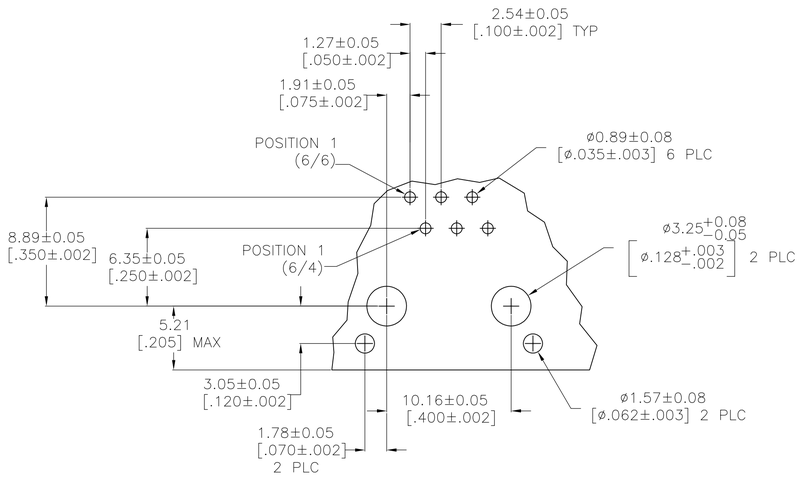


1 MATERIAL: HOUSING – PBT POLYESTER, COLOR: BLACK.
TERMINAL – 0.36[.014] THICK PHOS-BRONZE PLATED WITH 1.27um[.000050] MINIMUM THICK HARD GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA AND 3.81um[.000150] THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA OVER 1.27um [.000050] MINIMUM THICK NICKEL UNDERPLATE.
SHIELD – 0.25[.010] THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 3.0µm[.000120] MINIMUM REFLOWED TIN

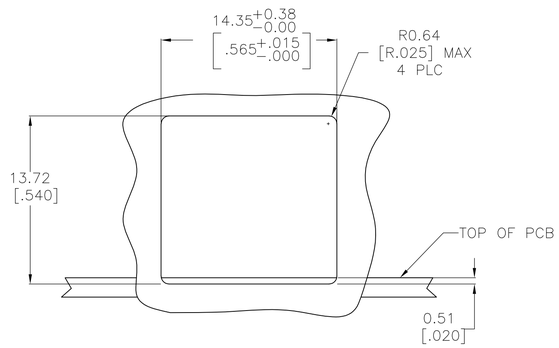
2 CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68, SUBPART F.

3 DIMENSIONS MEASURED ALONG FRONT EDGES OF MATING FACE

4 TERMINALS FOR 5555140-2 LOCATED IN CENTER POSITIONS.



RECOMMENDED PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



RECOMMENDED PANEL CUTOUT

PACKAGING	DIMENSION Z	TERMINALS REQUIRED	PART NUMBER
TUBE	3.81±0.51[.150±.020]	6	5555140-6
TRAY	2.54±0.25[.100±.010]	6	5555140-4
	3.81±0.51[.150±.020]	4 4	5555140-2
	3.81±0.51[.150±.020]	6	5555140-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± 0.13[.005]
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL: SEE NOTE 1
FINISH: SEE NOTE 1

DWN L.A.MAYER 08NOV2007
CHK P.RECCE 08NOV07
APVD S.FLICKINGER 08NOV07
PRODUCT SPEC 108-1163
APPLICATION SPEC 114-2048
WEIGHT –

TE Connectivity

NAME: MODULAR JACK ASSEMBLY, SHIELDED, 6POSITION, LOW PROFILE, RIGHT ANGLE, PANEL GROUND WITH PANEL STOPS

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-5555140	–

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 1 OF 1 | REV E1

4805 (3/11)

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9